



Le mot du Président

En ce début d'année 2017, il convient de dresser le bilan de nos activités 2016 ! Quatre évènements ont jalonné l'année dernière : Thermique à la Rochelle, *Interconex* à Paris, Puissance à Tours et enfin *Medical* à Lyon ; MiNaPAD n'a pas eu lieu du fait de l'organisation de ESTC2016 à Grenoble en septembre. Je tiens à saluer l'ensemble des membres du bureau IMAPS-France, qui ont bénévolement co-organisé ces évènements avec INTERCONEX.

Je n'oublie par nos exposants qui d'année en année nous assurent fidèlement de leur présence à ces évènements et participent à leur animation en journée et durant les diners de Gala !

Enfin, le bilan financier aura du mal à s'équilibrer pour 2016, en raison d'une faible affluence aux workshops *Interconex* et *Medical* malgré des programmes de bonne qualité. Si nous arrivons à maintenir le bon niveau des programmes de par le choix des sujets et la sélection des papiers, le succès d'un évènement se mesure également au taux de participation. C'est ainsi que pour un bon fonctionnement de notre société savante IMAPS et de la société INTERCONEX, votre participation à nos prochains évènements sera indispensable. J'en profite pour vous

rappeler de renouveler votre adhésion, c'est le moment.

Après cette rétrospective sur 2016, IMAPS-France vous propose de nous réunir pour 2017 autour des évènements emblématiques tels que *Thermique*, *Puissance*, *Medical*, de continuer notre parrainage de *DeMESys* et de co-organiser l'évènement *RAMP* avec l'IMAPS USA.

Pour terminer ce mot, nous allons développer et renforcer les partenariats avec des industriels, des associations, des pôles de compétitivités et d'autres chapitres IMAPS soit de façon opportuniste soit de façon plus durable.

Alexandre VAL

"Everything in electronics between the chip and the system" (ISHM – Une définition du Packaging)

Calendrier IMAPS France 2016- 2017

<p>Les 1 et 2 Février 2017, La Rochelle 12^{ème} ATW Micro Packaging and Thermal Management</p>
<p>Les 12 et 13 Avril 2017, Rabat (Maroc) 2nd DeMESys - (Parrainé par IMAPS-France)</p>
<p>Les 26 et 27 Avril 2017, Paris RAMP – RF and Microwave Packaging</p>
<p>Les 17 et 18 Mai 2017, Grenoble 5^{ème} Micro-Nano Electronics Packaging and Assembly</p>
<p>Octobre 2017, Tours 9^{ème} ATW Nano and Micro Power Electronics & Packaging</p>
<p>22 et 23 Novembre 2017, Lyon 5^{ème} ATW Microelectronics, Systems & Packaging for Medical Applications</p>

12th European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management

– La Rochelle –

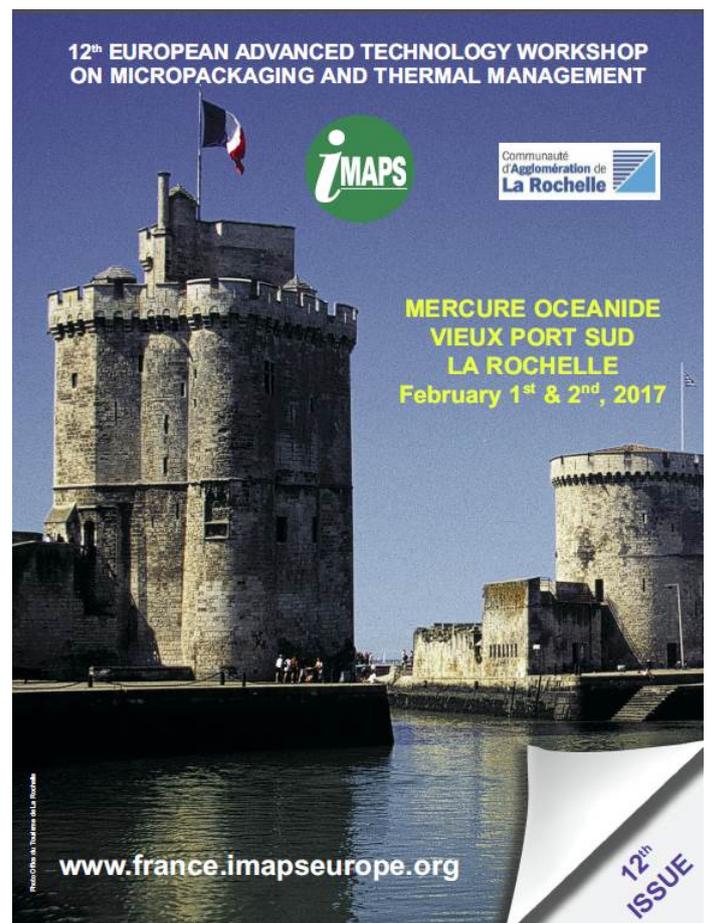
Jean-Yves Soulier

Zodiac Aerospace

Président de la conférence

Dans moins de 3 semaines se tient notre 12^{ième} workshop que j'aurai l'honneur de présider pour la deuxième année consécutive. Au terme d'un rush de trois mois et de nombreux aléas, nous avons bouclé un programme qui donne la part belle aux matériaux et commencera par un bref rappel historique d'IMAPS France et de son rôle joué dans la filière électronique, suivi d'un *keynote paper* de notre ami David Saums. De dimension internationale, le workshop donne cette année une tribune à des conférenciers venant des Etats Unis, de France, d'Allemagne, de Pologne, d'Autriche, d'Espagne et du Royaume-Uni. Je ne crains pas d'insister et de rappeler que ce workshop est, entre autres événements organisés par l'IMAPS, l'occasion pour chacun de développer son réseau et d'identifier le Who's Who du monde du packaging. Dans une période où les entreprises réduisent les bons de sortie pour leurs experts et spécialistes, qu'il me soit aussi permis de rappeler que nos deux journées d'échange et de conférences peuvent donner droit, sur demande auprès de Florence Vireton, à la remise d'une attestation de formation, délivrée par INTERCONEX, organisme certifié.

Au moment où j'écris ces lignes plus d'une soixantaine de personnes, conférenciers, exposants et auditeurs, se sont déjà inscrites, ce qui augure déjà d'une grande richesse d'échanges. Je souhaite donc vous voir aussi nombreux que l'an dernier où nous avons réuni plus d'une centaine de participants.



5ème MiNaPAD 2017

Jean-Luc DIOT

NovaPack

Président du Forum

Nous avons le plaisir de vous confirmer l'organisation de la cinquième édition du Forum MiNaPAD (Micro/Nano-Electronics Packaging and Assembly, Design and Manufacturing) les **17 et 18 Mai 2017**. Nous espérons vous rencontrer pendant ces deux jours de présentations techniques et d'échanges sur les stands d'exposition à **Grenoble** (au World Trade Center, proche de la gare). Le 16 mai, ces deux journées seront précédées le matin par quatre tutoriaux (packaging des MEMS, photonique, thermique et fiabilité) et l'après-midi par une conférence de Mervi Paulasto de l'université d'Aalto (Finlande), organisée conjointement avec CPMT, sur « New Materials Entering MEMS ».

L'appel à communications, avec le détail des thématiques (voir ci-dessous), est ouvert et nous attendons vos contributions. A vos stylos !!!

N'oubliez pas de marquer ces dates sur vos Agendas :

17 et 18 Mai 2017 à Grenoble



5th Micro/Nano-Electronics Packaging & Assembly, Design and Manufacturing Forum

Conference & Exhibition organized by IMAPS
Email: imaps.france@imapsfrance.org. Web: www.france.imapseurope.org



Call for Papers
Deadline January 27th, 2017

5th MiNaPAD Forum 2017

WTC Grenoble, France
May 17-18, 2017



« *Bringing closer Design, Semiconductor, Assembly & Packaging communities* »

General chair: Jean-Luc Diot, Vice Technical Chairs: Michel Garnier & Gilles Poupon

Abstracts are requested on the following topics (350 words min., one page max):

- Advanced Packaging: 2.5/3D Packaging, TSVs, interposers, wafer level packaging, fan-out WLP and embedded IC package, substrates (flexible, ceramic, laminates), PCB
 - CAD and tools for I/O placement for advanced packaging, design for reliability, IC and package co-design, opto & RF package design, thermal & mechanical modeling & simulation
 - Digital deep submicron technologies for scaling nodes MEMS, sensors, actuators, RF miniaturization, smart system packaging & heterogeneous integration
 - Innovative packaging for emerging and growing applications: photovoltaic, wearable, medical electronics, bio-MEMS, Lab-on-chip power, LEDs, photonics, optoelectronics...
 - Materials (adhesives, underfills, molding, dielectrics...), equipment and processes
 - Emerging technologies and novel approaches: microfluidics, Carbon Nano Tubes, nanoscale integration
 - Assembly manufacturing (BGA/CSP/QFP/QFN, flux, cleaning, dispensing, coating,...) and business aspects of the industry
 - Reliability, wear out, test and characterization, electromigration, thermal management, power signal integrity
 - Advanced interconnections: flip-chip, interconnections for advanced CMOS process nodes, WLP metallurgies, bumping techniques, non-traditional interconnections, PCB solutions, optical connection
- Your submission must include the mailing address, business telephone number and email address and the content must be without commercial information.
• Address your abstract to imaps.france@imapsfrance.org
• Authors will be notified of paper acceptance with instructions for publication before **March 19th, 2017**
• Authors will be invited to submit a paper (no format) for proceeding publication (2 to 6 pages) before **April 14th, 2017**
• At the discretion of the program committee, submitted abstracts may be considered for poster presentation.
• Presentations conforming to the IMAPS template are **April 28th, 2017**
• Special student poster session: a poster session for students will address all of the above topics



2^{ème} DEMESYS 2017

Imane AZZOUZI

MAScIR- Rabat

General Chairwoman

Trois mois seulement nous séparent de la deuxième édition de DEMESYS. L'appel à communications, avec le détail des thématiques et dates importantes (disponible sur le site IMAPS) est toujours ouvert, vous pouvez envoyer vos contributions pour faire partie du programme de conférence.

Les Keynotes sont en cours de validation et seront bientôt publiés. En phase avec les larges thématiques de l'évènement, ils porteront principalement sur :

- Les nouvelles techniques de packaging,
- L'électronique de puissance et les applications *automotive*,
- Les solutions de financement pour vos Projets.

Nous vous invitons aussi à réserver votre stand dans la zone d'exposition, lieu privilégié d'échanges entre les différentes sociétés présentes.

Dernier point, mais pas le moindre, nous sommes ouverts à vos suggestions pour le programme social de la soirée du 12 Avril. N'hésitez pas si vous avez des préférences pour la visite de la ville de Rabat ou pour le diner.



RaMP 2017

26 et 27 Avril à Paris

General Co-Chairs

Brigitte Braux (Imaps France)

And Ken Kuang

(Torrey Hills Technologies, LLC)



N'oubliez pas de bloquer vos agendas pour ces deux jours à Paris en Avril 2017.

L'appel à Communications est paru et les propositions de résumés sont attendues jusqu'au 15 février.

Le programme technique se construit avec un comité d'organisation mondial et l'on attend déjà une forte délégation asiatique pour cet évènement. Dès la fin février les conférences vous seront proposées sur des thèmes abordant bien sûr le packaging mais sur un très large spectre d'applications tant numériques qu'analogiques.

L'occasion pour tous de découvrir la diversité des solutions de packaging dans des domaines très variés.

Une session dédiée aux Télécommunications vous sera proposée avec une présentation de la progression de la « 5G » en Chine où le gouvernement fait un effort considérable pour développer cette technologie et la mettre en œuvre très

rapidement, avec un but avoué : faire repartir la croissance économique par ce biais.

Réussiront-ils leur pari ? L'avenir nous le dira mais cette session particulière sera pour les auditeurs l'occasion de prendre des informations très concrètes auprès des acteurs de cette filière. L'exposition avec table top est aussi lancée et il reste encore quelques opportunités pour ceux qui le souhaitent.

Les contacts sont inchangés :

- brigitte.braux-touchat@orange.fr

ou

- imaps.france@imapsfrance.org

Informations diverses

Nouveauté Centre Français Fiabilité

samuel.cutullic@nae.fr

02.32.80.88.00

Samuel CUTULLIC

FIABILITÉ: Sociétés & Communautés savantes

2016

Création du CFF

SCHIMMERLING Paul : paul.schimmerling@renault.com
DELAUX David : david.delaux@valeo.com
MEURET Régis : regis.meuret@labinal-powers.com
GRZESKOWIAK Henri : henri.grzeskowiak.fr
AIT-YOUNES Tarik : tarik.ait-younes@analyses-surface.com
LARRY Olivier : olivier.larry@univ-roren.fr
MAAMANE Hichame : hichame.maamane@thalesgroup.com
EUDELIN Philippe : philippe.eudelin@thalesgroup.com
PARIS Xavier : xavier.paris@thalesgroup.com
DAVENEL Franck : franck.davenel@intradef.gouv.fr
MARTIN Geoffrey : geoffroy.martin@pole-moveo.org
COUPE Severine : severine.coupe@pole-astech.org
CUTULLIC Samuel : samuel.cutullic@nae.fr

Associations



Communautés



Clusters

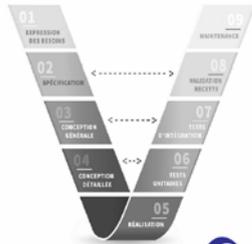


Centre Français Fiabilité

Pour qui?

- ✓ En s'appuyant sur le réseau des sociétés et des communautés savantes de Fiabilité.
- ✓ En testant cette initiative sur un territoire propice: la Normandie.
=> Stratégie de spécialisation, feuille de route structurante, compétences reconnues.
- ✓ En favorisant une approche inter-filière: aéronautique, défense, automobile, etc.
- ✓ En facilitant l'émergence de projets collaboratifs structurants.

- 1 | Aéronautique & Aérospatial
- 2 | Automobile & Ferroviaire
- 3 | Défense & Sécurité
- 4 | Industries
- 5 | Nucléaire
- 6 | Sports & Loisirs



Centre Français Fiabilité

4 Thèmes prioritaires



- ✓ Les connaissances et les moyens d'investigation sur les matériaux « électriques » et les composants.
- ✓ Les systèmes mécatroniques.
- ✓ Les technologies liées à la connectique.
- ✓ Le packaging des électroniques miniaturisées et la dissipation thermique.



Centre Français Fiabilité

PLAN D'ACTION

Choisir Centre Français de Fiabilité

- ✓ Réseau « Fiabilité »
➢ Objectif: Animer et coordonner un réseau « Fiabilité » fédérant les acteurs de cette thématique
- ✓ Comité scientifique et technique
➢ Objectif: Proposer une expertise et un suivi des projets relevant de la fiabilité des systèmes et des composants
- ✓ Capitalisation de connaissance
➢ Objectif: Formaliser et décliner une solution de capitalisation de connaissance s'appuyant sur les résultats des projets d'innovation / collaboratifs au travers des sociétés savantes de France
- ✓ Expertise technique
➢ Objectif: Mettre à disposition des PME un réseau d'expert pour la résolution de problèmes techniques / technologiques liés à la fiabilité

Objectif: Aider les industriels (grands groupes et PME/ETI) à améliorer la fiabilité de leurs produits par l'accompagnement de projet collaboratif et de résolution de problèmes concrets.



Centre Français Fiabilité

Le 19 Janvier 2017, Save the date !

HORIZON 2020

Un webinar sur Eurostars proposé par nos experts PNO Consultants !

Le programme de financement européen Eurostars vise à soutenir la R&D des PME innovantes.

Le taux de succès d'un projet Eurostars est de 30%, l'un des plus élevés du programme européen H2020.

Durant ce webinar, nous vous guiderons à travers les méandres du programme Eurostars. Nous vous donnerons des exemples de projets et développerons quelques astuces pour déposer un excellent dossier Eurostars.

Je m'inscris à ce webinar Eurostars !

Nous vous invitons à participer à ce webinar gratuit qui se tiendra le 19 Janvier 2017 de 15h à 16h. Vous recevrez la liste de tous les participants afin de trouver des partenaires potentiels, et vous aurez la possibilité de chatter avec nos consultants experts.

Adhésions

N'oubliez pas de renouveler vos adhésions pour la prochaine année.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : Florence Vireton par messagerie : sur imaps.france@imapsfrance.org

ou par téléphone au 01 39 67 17 73

Visitez également notre nouveau site Internet : www.france.imapseurope.com

Prochaine édition : Avril 2017